

# 半導体集積化における 3次元集積実装技術の最新技術動向

- ◆日 時：2022年03月16日(水) 13:00～17:00
- ◆会 場：【WEB限定セミナー】  
※在宅、会社いながらセミナーを受けられます
- ◆受講料：1名につき49,500円(税込、資料付)
- ※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。  
・1名でお申込みされた場合、1名につき**46,200円(税込)**  
・2名同時でお申し込みされた場合、**2人目は無料(2名で49,500円(税込))**

## セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

(国研)産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門 3D集積システムグループ 研究グループ長 博士(工学) 菊地 克弥 氏

これまでの国家プロジェクトや国際会議を中心に3次元集積実装技術の研究開発動向をお話しいたします。

<p>1. はじめに</p> <p>2. 国家プロジェクトを通じた3次元集積実装技術の研究開発</p> <p>2-1 国家プロジェクトでの3次元集積実装技術の要素技術開発 (FY1999～FY2012)</p> <p>2-2 3次元集積実装技術による車載用障害物センシングデバイス開発 (FY2013～FY2017)</p> <p>2-3 ハードウェアセキュリティ研究における3次元集積実装技術の研究開発 (FY2015～FY2021)</p> <p>2-4 3次元集積実装技術によるIoTデバイス試作開発拠点の構築 (FY2016～FY2017)</p>	<p>2-5 ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業における 3次元集積実装技術の研究開発(FY2021～)</p> <p>3. 国家プロジェクト外での産総研での 3次元集積実装技術の研究開発の取り組み</p> <p>4. 3次元集積実装技術の最新の技術研究動向 ～ IEDM 2020、ECTC2021、VLSI Symposia 2021 ～</p> <p>4-1 IEDM2020におけるMore than Moore技術研究動向</p> <p>4-2 ECTC2020におけるMore than Moore技術研究動向</p> <p>4-3 VLSI Symposia 2021におけるMore than Moore技術研究動向</p> <p>5. まとめ</p>
--	--

### 『半導体集積化【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学			
住 所	〒		
電話番号		FAX	
お名前	所属	E-Mail	
①			
②			
会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。		<input type="checkbox"/> Eメール <input type="checkbox"/> 郵送	

●セミナーの受講申込みについて●  
必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたしまして、別途視聴用のURLをメールにお送りいたします。  
セミナーお申込み後のキャンセルは基本的に受け付けておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

受講料の支払いに関してはHPをご覧ください。  
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>  
個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。  
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>



株式会社R & D支援センター

〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-24 VORT東陽町ビル 7F  
TEL) 03-5857-4811 FAX) 03-5857-4812 URL) <http://www.rdsc.co.jp/>